

苏州国芯科技股份有限公司

2023年4月投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	汇添富基金；天弘基金；中信证券；申万菱信基金；景顺长城基金；平安基金；长安基金；中金基金；兴银基金；永赢基金；创金合信基金；工银瑞信基金；国泰基金；银华基金；长盛基金；惠通基金；朱雀基金；易米基金；玄元私募基金；金信基金；恒越基金；中邮创业基金；长江证券；光大证券；誉辉资本；碧云资本；万博兄弟资产；中信建投证券；广发证券；银河证券；申万宏源证券；东吴证券；筌笠资产；乾惕投资；润晖投资；湘楚资产；丹羿投资；长城财富保险；浙商证券；泰康资产香港；东盈投资；东吴自营；凯恩（苏州）私募基金；Hel Ved Capital；北大方正人寿资管；深圳前海百创资本管理；磐厚动量；广州全控资产；恒生前海基金管理；佳睿（晋江）私募基金管理；上海雷根资产管理；Prudence investment Management (Hong Kong) Limited；上海趣时资产管理；上海远策投资管理；深圳市领骥资本；泰康资产；誉辉(深圳)私募证券基金；深圳博普科技；中天证券；相聚资本；江西博玉东方实业；华夏财富创新投资管理；中泰证券；青岛伟晟投资管理；华创证券；上海标朴投资管理；中国银河证券；国泰君安证券；国联证券；广州金控资产管理；西部证券；东方证券；中邮证券；星仪资本；上海东方证券资产管理；上海盘京投资管理；长城证券；兴业证券；敦和资产管理；深圳博普科技；华强资管；民生证券；磐安国新；广州市龙智投资管理；无锡中微亿芯；国投安信期货；国信证券；广东竣弘投资管理；财通证券资产管理；上海德邻众福投资管理；万联证券；安信证券；招商证券资产管理；华美国际投资集团；泓德基金管理；上海大

	朴资产管理；方正证券；东北证券；丰琰投资管理（浙江自贸区）；苏银理财；英大保险资产管理；圆信永丰基金；上海南土资产管理；汇泉基金；建信基金管理；上海和谐汇一资产管理；上海途灵资产管理；海通资管；浙江巽升资产；西部利得基金。
时间	2023年4月28日10:00 2023年4月28日15:00
地点	线上交流及公司现场交流
上市公司 参加人员 姓名	董事长：郑荏先生 董事会秘书：黄涛先生 证券事务代表：龚小刚先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司2022年和2023年第一季度的经营情况？</p> <p>答：2022年，公司实现营业收入5.25亿元，较上年同期增长28.83%；实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，较上年同期增长9.55%。按应用领域来分，报告期内，公司信息安全收入2.02亿元，较上年同期减少18.30%；汽车电子和工业控制收入1.89亿元，较上年同期增长127.51%；边缘计算和网络通信收入1.21亿元，较上年同期增长71.41%。</p> <p>2023年第一季度，公司实现营业收入1.36亿元，较上年同期增长173.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,857,045.07元，较上年同期下降8,837.89%。按应用领域来分，报告期内，公司信息安全收入2,194万元，较上年同期（3,558万元）减少38.33%；汽车电子和工业控制收入3,070万元，较上年同期（932万元）增长229.24%；边缘计算和网络通信收入7,549万元，较上年同期（291万元）增长25倍。</p> <p>2、公司的发展战略是什么？</p> <p>答：未来，公司继续坚持“顶天立地”的发展战略和坚守长期主义的发展策略，立足国家重大需求和市场需求领域客户，聚焦于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键应用领域，持续发展我国自主可控高端嵌入式CPU系列，持续推出系列化的高端自主芯片及模组产品矩阵，满足各类客户的需求，特别是重点推进汽车电子、“云-边-端”和高可靠存储业务的发展，实现国产化替代，为解决我国高端芯片核心技术受制于人的</p>

问题做出应有的贡献。公司的具体的发展战略主要包括：（1）成为我国嵌入式 CPU 领域具备国际竞争力的企业，充分发挥在自主可控嵌入式 CPU 技术和面向行业应用的 SoC 芯片设计平台技术的优势地位，对标全球一流嵌入式 CPU 厂商的前沿技术，基于开源或已获授权的指令集，设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗 CPU 内核，成为中国国产嵌入式 CPU 的核心供应商之一。（2）成为中国信息安全芯片产品的领先供应商之一。在信息安全领域，公司将基于自主可控嵌入式 CPU 的核心技术和新一代高性能可重构密码处理技术，紧密围绕“云”“边”到“端”的安全需求，开发全系列的芯片、模组和解决方案，覆盖云计算、大数据、边缘计算、终端计算和网络通信等领域，以及金融电子、工业控制、智能电网和智能家居等行业。（3）成为中国汽车电子芯片产品的领先供应商之一。在汽车电子领域，公司将围绕车身和网关控制芯片、汽车动力总成控制芯片、汽车域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、汽车电子混合信号类芯片和汽车电子专用 SoC 芯片等 7 条产品线进行系列化的全面布局，努力实现汽车电子 MCU 芯片在产品系列化和性能指标两方面向国际一流厂商相媲美。继续狠抓研发和市场拓展，努力实现高端汽车电子芯片的规模化销售，总体确立公司在国内汽车电子芯片领域的领头地位。（4）成为中国高可靠存储 Raid 控制芯片的核心供应商。在云存储领域，积极开发高性能高可靠 RAID 存储控制芯片等产品，实现 Raid 芯片产品系列化，可替代国际一流厂商芯片产品，为解决国家在特定领域的无“芯”之痛提供助力，打造公司的重要增长极。

3、请介绍一下公司 2022 年汽车电子业务的总体情况？

答：在汽车电子芯片领域，受国家对汽车产业政策带动、汽车缺芯、国产替代等因素的大力推动，2022 年国产汽车芯片需求继续旺盛，公司汽车电子芯片业务获得较为快速的发展。公司的汽车电子芯片产品覆盖面较全，已在 7 条产品线上实现系列化布局，公司致力于成为国内汽车电子芯片的领先供应商，2022 年，国芯科技建设的“江苏省汽车电子芯片工程研究中心”被认定为江苏省工程研究中心，牵头建设苏州自主可控智能汽车电子芯片创新联合体，2022 年公司汽车电子芯片实现 400 余万颗的出货，2022 年出货量同

比增加十倍以上，汽车电子业务的收入实现大幅度增长。

4、贵公司的汽车车身和网关控制芯片进展怎么样？

答：公司于 2022 年 4 月推出的 CCFC2012BC 中高端车身及网关控制芯片，可对标国外产品如 NXP（恩智浦）MPC5604BC、MPC5607B 系列以及 ST（意法半导体）的 SPC560B50、SPC560B64 系列，受到市场的普遍欢迎。公司基于 CCF2012BC 芯片还开发系列化车身/网关控制芯片 CCFC2010BC/CCFC2011BC，覆盖中到高的市场应用，包括整车控制、车身网关、安全气囊、无钥匙启动、T-BOX 以及空调、座椅和车灯控制等应用，可实现对国外产品的替代，覆盖新能源车和传统乘用车等。目前下游的涵盖整车客户包括比亚迪、上汽、长安、奇瑞、东风等。

5、公司域控芯片的进展如何？

答：公司在 2022 年 11 月已经完成汽车域控制器芯片 CCFC2016BC（中端的域控制器芯片）的研发，该芯片的产品定义过程中充分征求了国内头部新能源汽车厂商的意见。同时，公司正在研发高端的域控制芯片 CCFC3007PT、CCFC3008PT 和 CCFC3009PT 芯片系列，在 2023 年第一季度完成高端的域控制芯片 CCFC3008PT 的设计，并投入工程批量产。

6、请谈谈公司车规级安全 MCU 芯片的发展情况？

答：公司已成功开发 CCM3320S、CCM3310S-H 和 CCM3310S-T 等三款汽车电子安全芯片产品，形成高、中、低产品系列，其中 CCM3310S-T/CCM3310S-H 已批量供货，CCM3320S 正在进行客户验证阶段，主要对标国际领先厂商有恩智浦和英飞凌相关产品，主要应用包括车联网 C-V2X 通信安全应用（高端）、车载 T-BOX 安全单元（中端）和国六尾气检测车载诊断系统（OBD）安全单元（低端）等。CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片获颁国内首批汽车安全芯片可信安全认证证书，经中国汽车技术研究中心有限公司软件测评（天津）有限公司测试，CCM3310S-T、CCM3310S-H 车规级芯片满足 ACS-EAL5+ 等级要求，达到目前国内安全芯片在汽车行业专业安全认证方面的最高等级。同时公司基于客户需求开发了新一代汽车信息安全芯片产品 CCM3305S，该款芯片支持通信接口 USB3.0，对称算法在端口处实现同时接受和发送超过 200Mbps。

7、公司汽车电子混合信号类芯片的最新情况是什么样的？

答：面对国产替代的机会，公司启动了安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片、桥接与预驱专用芯片 CCL1100B 芯片和 NFC 射频收发芯片的研发工作，目前进展顺利。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片和公司 CCFC2012BC 微控制器芯片可以组成高度紧凑的双芯片安全气囊 ECU。芯片将电源模块、触发回路模块、传感器接口模块和复杂的安全模块集成在一个芯片上。桥接与预驱专用芯片 CCL1100B 芯片则是面向车门、窗、后视镜的执行器使用的桥接与预驱专用芯片。面向汽车 PEPS（无钥匙进入）应用，公司开发了首款 NFC 射频收发芯片。安全气囊点火驱动芯片 CCL1600B 芯片和 NFC 射频收发芯片 2023 年第一季度投产。

8、公司 Raid 存储管理芯片最新情况如何？

答：公司已成功开发基于公司 C*Core CPU 内核 C8000 的第一代 Raid 芯片产品，具备多个独立的接口通道、支持连接最多 40 个机械硬盘或 SSD 固态存储盘，兼容 PCIE 标准开发，实现数据的高可靠、高效率存储及传输管理，该芯片支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10，具有高性能、大缓存、低功耗等特点，可广泛应用于图形工作站、服务器数据库存储、金融数据库存储等领域。经过多个客户的应用验证，为更好地满足市场应用需求，公司对第一代 Raid 芯片产品进行了设计修改，主要包括 RAID 引擎增加至 4 组（原来 1 组）以进一步提高性能、增加 SRAM 至 2MB（原来 128KB 左右）以更好满足软硬件应用和增加 SATA 数量至 16 个（原来 8 个）以更多地覆盖诸如 AI 服务器对存储容量的要求。公司目前第一代改进型 Raid 芯片产品已进行量产流片，2023 年 4 月中旬完成晶圆流片。同时，公司正在基于自主高性能 RISC-V CPU 研制开发新一代更高性能的 Raid 芯片，目前各项工作进展顺利，未来有望达到国际主流 Raid 芯片的性能。Raid 芯片是服务器中广泛应用的一个重要芯片产品，长期以来被国外公司垄断，急需实现国产化替代。

9、公司边缘计算芯片未来前景怎么样？

答：在边缘计算和网络通信领域，公司研发的芯片具备多核计算、网络路径和协议加速引擎、路由转发以及多种高速通信接口，适用于边缘计算与

网络通信领域产品的计算、安全及通信需求。公司高性能边缘计算芯片 H2040 集成了计算、安全和网络通信功能，基于 28nm 工艺设计，采用国芯 32 位四核的 PowerPC 指令架构 CPU 核，集成 DDR3.0、PCIe3.0、千兆网、SATA2.0、RapidIO2.0 等接口，已完成流片和芯片测试，处于国内先进水平，可用于边缘计算和通用嵌入式计算中的综合控制、安全处理、数据通路和应用层处理；公司高性能高安全边缘计算芯片 CCP1080T，基于 14nm 工艺设计，采用国芯 64 位多核 PowerPC 架构 CPU 核，集成高性能密码算法引擎、网络数据加速引擎、具有千兆和万兆以太网接口、PCIe3.0、USB3.0 和 DDR4 等高速接口，已完成晶圆流片和芯片测试，现在客户应用验证中，可用于边缘网关、VPN、微服务器等设备的主控芯片。

10、2022 年公司定制芯片业务情况怎么样？

答：2022 年，公司结合自身信息安全、汽车电子和工业控制以及边缘计算和网络通信等芯片平台技术积累，在合作中努力寻找抓住关键客户的主力芯片更新换代机会，特别是定制芯片量产服务的机会，提升自身技术能力的同时，带来芯片定制化服务业务新的增长点，做出优势与特色，目前公司芯片定制服务领域的订单充足。同时公司定制芯片服务业务内容实现与公司自主芯片业务的相辅相成，互为促进。

2022 年公司定制芯片服务收入为 2.57 亿元，其中定制芯片设计服务收入 1.07 亿元，定制芯片量产服务收入 1.50 亿元，与上年同期相比分别上升 176.57%、125.65%和 229.35%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计为超过 107 家客户提供超过 151 次的 CPU 等 IP 授权，累计为超过 90 家客户提供超过 192 次的芯片定制服务。

11、围绕公司自身的业务，公司产业链生态建设的进展情况是什么？

答：2022 年 5 月，为加快解决国内汽车电子 MCU 芯片 95%以上依赖进口的难题，国芯科技牵头整合了长三角区域的江苏产研院（江苏集萃）、清华苏州汽研院和吉利等 8 家产业链上下游优势企业，共同组建、成立了“苏州自主可控智能汽车电子芯片创新联合体”，致力于建设自主可控的“芯片设计-车规测试-控制模组-整车应用”生态链，解决“卡脖子”问题，实现汽车产业的供应链安全。目前，该联合体围绕车身及网关控制 MCU 芯片、高

	<p>可靠发动机控制 MCU 芯片、域控制 MCU 芯片、新能源电池管理控制 MCU 芯片等多个方向协同开展芯片设计、封装测试、模组开发和应用方案、整车应用的联合攻关，逐步建立形成自主可控的产业生态和国产化供应链。同时，国芯科技的汽车电子研发中心被认定为 2022 年江苏省汽车电子芯片工程研究中心。</p> <p>12、2023 年，贵公司将重点开展哪些工作？</p> <p>答：2023 年，站在新的起点上，在公司董事会的带领下，公司将继续坚持“顶天立地”的发展战略，围绕公司发展规划，坚守长期主义的发展策略，抓住 CPU 国产替代的发展机遇，在全力推进自主嵌入式 CPU 及其相关 SoC 芯片平台的技术创新的基础上，围绕“头部客户”，树立“客户”第一的理念，继续加强团队建设，紧紧围绕公司汽车电子芯片、信创和信息安全芯片等重点发展方向，推进公司资源优化和聚焦，注重产品技术平台化、流程规范和标准化，加强企业精细化管理和人才队伍建设，持续促进公司业务做大做强。重点做好以下工作：发展汽车电子、“云-边-端”和高可靠存储控制等关键领域的自主芯片业务；以品牌建设为引领，不断拓展市场和客户；积极加强募投项目的建设，重点开展新技术、新产品研发；推进上市公司规范运作，加强企业精细化管理；进一步加强人才激励和人才队伍建设。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 4 月</p>